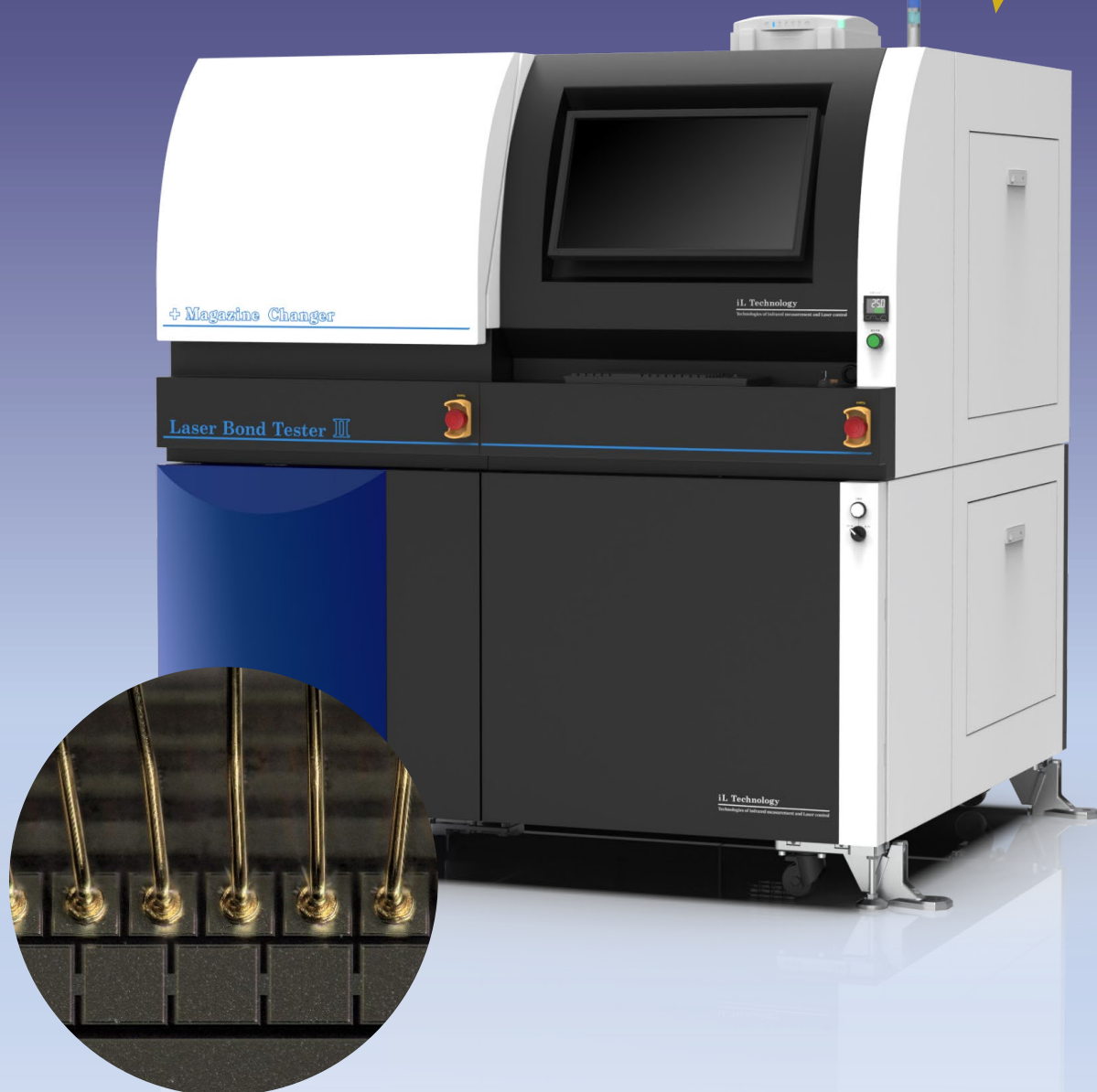


非破壊

レーザーボンドテスター

Laser Bond Tester II + Magazine Changer

業界初！



< 全自動測定 >

金ワイヤボンドの 非破壊 非接触 瞬時測定 を初実用化！

iL Technology

Technologies of Infrared measurement and Laser control

Ver. 2.1

概要仕様

| | |
|------------------|---|
| 測定方法 | レーザー周期加熱式接合部位測定法 *4) |
| 測定対象 | 金/銅 ワイヤ接合部位 *1) ワイヤ径: $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$ *1) |
| 測定値 | 位相値(接合部位の熱抵抗と強相関) |
| 測定結果表示 | 位相値・接合面積*3)・接合係数*3)・変換値分布グラフ(下限上限閾値を設定)・ 変換値変位グラフ(測定安定時間を確認)・測定値強度ベクトルグラフ・良否判定 |
| 測定結果出力 | 画面表示及びCSVファイル内容 |
| 測定時間 | ボンド当たり実質測定時間: 1ms~15ms/ボンド 位置移動時間及び画像処理時間: 0.5~3秒/ボンド |
| リードフレーム寸法 | W: 20mm~110mm L: 90mm~300mm t: 0.1mm~0.5mm |
| マガジン寸法 | W: 30mm~120mm L: 100mm~310mm H: 100mm~200mm |
| マガジnstock数 | 3個 |
| 画像処理機能 | 最適測定位置認識機能・簡易寸法測定・つぶれ幅測定 |
| レシピ作成 | 手入力・ティーチング入力・外部作成データ入力・座標変換(オプション) |
| レシピ入力情報 | マガジン情報・リードフレーム情報・ボンド情報・測定条件・良否判定等 |
| 電源 | 三相AC200V 30A/max・要接地(D種) |
| 測定用レーザー | 半導体レーザー *1) *2) |
| 使用レーザークラス | クラス4: JIS C 6802:2018 / IEC 60825-1:2014 準拠 |
| 装置レーザークラス(通常運用時) | クラス1相当 |
| 装置安全基準 | ISO 13849-1 / JIS B 9705:2019 準拠 |
| 装置本体外形寸法 | W: 1500mm D: 1400mm H: 1600mm *5) (暫定仕様) |
| 重量 | 約650kg (暫定仕様) |
| 動作環境 | 温度: 22~25°C・湿度: 85%RH以下・粉塵無き事 |

※1) 測定対象毎に測定条件や加熱レーザーの調整などが必要です。

※2) 本装置のレーザーはクラス4製品です。ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けて下さい。

※3) 回帰式による変換値です。

※4) 測定方法は、株式会社ジェイテクトのpatentに基づいています。

※5) 外形寸法は突起部を含みません。筐体部分のみの寸法で、上部のパラライト寸法などは含まれていません。

※6) 本装置は温度調整ユニット用に工業用純水が必要です。(内部循環式)

※7) 本装置は機能・性能向上の為、お断りなく仕様変更される場合があります。

※8) “レーザーボンドテスター”及び“Laser Bond Tester”は、アイエルテクノロジー株式会社の登録商標です。



製造元

il Technology Corporation

アイエルテクノロジー株式会社

愛知県岡崎市針崎1丁目1番地13

TEL: 0564-73-2005

URL: <http://www.il-tech.jp>